

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-335775

(43)Date of publication of application : 17.12.1996

(51)Int.Cl.

H05K 3/38

C25D 5/12

C25D 7/06

H05K 1/09

(21)Application number : 07-164547

(71)Applicant : NIKKO GOULD FOIL KK

(22)Date of filing : 08.06.1995

(72)Inventor : ARAI EITA

HINO EIJI

(54) METHOD FOR TREATING COPPER FOIL IN PRINTED CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the heat resistant stripping properties furthermore in the method for treating a copper foil in printed circuit by forming a cobalt plating layer or a plating layer composed of cobalt and nickel after roughening the surface of the copper foil by plating of copper - cobalt - nickel.

CONSTITUTION: After roughening the surface of a copper foil by plating copper - cobalt - nickel alloy with adhesion quantity of 15-40mg/dm² copper, 100-3000μg/dm² cobalt, and 100-1000μg/dm² nickel, a cobalt plating layer is formed with adhesion quantity of 200-3000μg/dm² followed by formation of a zinc layer with adhesion quantity preferably of 20-60μg/dm², more preferably of 30-50μg/dm². Finally, it is subjected to rustproof treatment.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.08.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2875186

[Date of registration]

14.01.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-335775

(43) 公開日 平成8年(1996)12月17日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 5 K 3/38		7511-4E	H 0 5 K 3/38	C
C 2 5 D 5/12			C 2 5 D 5/12	
	7/06		7/06	A
H 0 5 K 1/09		7511-4E	H 0 5 K 1/09	Z

審査請求 未請求 請求項の数6 F D (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平7-164547

(22) 出願日 平成7年(1995)6月8日

(71) 出願人 591007860

日鉱グールド・フォイル株式会社
東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

(72) 発明者 新井 英太

茨城県日立市白銀町3丁目3番1号日鉱グ
ールド・フォイル株式会社日立工場内

(72) 発明者 日野 英治

茨城県日立市白銀町3丁目3番1号日鉱グ
ールド・フォイル株式会社日立工場内

(74) 代理人 弁理士 倉内 基弘 (外1名)

(54) 【発明の名称】 印刷回路用銅箔の処理方法

(57) 【要約】

【目的】 銅-コバルト-ニッケルから成るめっきによる粗化処理後、コバルトめっき層或いはコバルト及びニッケルから成るめっき層を形成する印刷回路用銅箔の処理方法において耐熱剥離性を更に一層改善すること。

【構成】 銅箔の表面に付着量が $15 \sim 40 \text{ mg/dm}^2$ 銅- $100 \sim 3000 \mu\text{g/dm}^2$ コバルト- $100 \sim 1000 \mu\text{g/dm}^2$ ニッケルの銅-コバルト-ニッケル合金めっきによる粗化処理後、 $200 \sim 3000 \mu\text{g/dm}^2$ の付着量のコバルトめっき層を形成し、更に $10 \sim 80 \mu\text{g/dm}^2$ 、好ましくは $20 \sim 60 \mu\text{g/dm}^2$ 、一層好ましくは $30 \sim 50 \mu\text{g/dm}^2$ 付着量の亜鉛層を形成する。更に防錆処理を施す。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 印刷回路用銅箔の処理方法において、銅箔の表面に銅-コバルト-ニッケルから成るめっきによる粗化処理後、コバルトめっき層を形成し、更に亜鉛層を形成することを特徴とする印刷回路用銅箔の処理方法。

【請求項 2】 前記亜鉛層を形成した後に防錆処理を施すことを特徴とする請求項 1 の印刷回路用銅箔の処理方法。

【請求項 3】 防錆処理がクロム酸化物の単独皮膜処理或いはクロム酸化物と亜鉛及び（又は）亜鉛酸化物との混合皮膜処理であることを特徴とする請求項 2 の印刷回路用銅箔の処理方法。

【請求項 4】 印刷回路用銅箔の処理方法において、銅箔の表面に付着量が $1.5 \sim 40 \text{ mg/dm}^2$ 銅-100 \sim 3000 $\mu\text{g/dm}^2$ コバルト-100 \sim 1000 $\mu\text{g/dm}^2$ ニッケルであるような銅-コバルト-ニッケルから成る合金めっきによる粗化処理後、200 \sim 3000 $\mu\text{g/dm}^2$ の付着量のコバルトめっき層を形成し、更に10 \sim 80 $\mu\text{g/dm}^2$ 付着量の亜鉛層を形成することを特徴とする請求項 1 \sim 3 いずれか 1 項の印刷回路用銅箔の処理方法。

【請求項 5】 印刷回路用銅箔の処理方法において、銅箔の表面に付着量が $1.5 \sim 40 \text{ mg/dm}^2$ 銅-200 \sim 3000 $\mu\text{g/dm}^2$ コバルト-200 \sim 400 $\mu\text{g/dm}^2$ ニッケルであるような銅-コバルト-ニッケルから成る合金めっきによる粗化処理後、500 \sim 3000 $\mu\text{g/dm}^2$ の付着量のコバルトめっき層を形成し、更に20 \sim 60 $\mu\text{g/dm}^2$ 付着量の亜鉛層を形成することを特徴とする請求項 1 \sim 3 いずれか 1 項の印刷回路用銅箔の処理方法。

【請求項 6】 亜鉛層の付着量が30 \sim 50 $\mu\text{g/dm}^2$ である請求項 5 の印刷回路用銅箔の処理方法。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【産業上の利用分野】 本発明は、印刷回路用銅箔の処理方法に関するものであり、特に銅箔の表面に銅-コバルト-ニッケルから成るめっきによる粗化処理後、コバルトめっき層を形成することにより、アルカリエッチング性を有し、しかも良好な耐熱剥離強度及び耐熱酸化性を具備すると共に黒色の表面色調を有する印刷回路用銅箔を生成する処理方法において、耐熱酸化性を更に一層改善する印刷回路用銅箔の処理方法に関するものである。本発明銅箔は、例えばファインパターン印刷回路及び磁気ヘッド用FPC（Flexible Printed Circuit）として特に適する。

【0002】

【従来の技術】 銅及び銅合金箔（以下銅箔と称する）は、電気・電子関連産業の発展に大きく寄与しており、特に印刷回路材として不可欠の存在となっている。印刷

回路用銅箔は一般に、合成樹脂ボード、フィルム等の基材に接着剤を介して或いは接着剤を使用せずに高温高圧下で積層接着して銅張積層板を製造し、その後目的とする回路を形成するべくレジスト塗布及び露光工程を経て必要な回路を印刷した後、不要部を除去するエッチング処理が施される。最終的に、所要の素子が半田付けされて、エレクトロニクスデバイス用の種々の印刷回路板を形成する。印刷回路板用銅箔に関する品質要求は、樹脂基材と接着される面（粗化面）と非接触面（光沢面）とで異なり、それぞれに多くの方法が提唱されている。

【0003】 例えば、粗化面に対する要求としては、主として、

- ①保存時における酸化変色のないこと、
 - ②基材との引き剥し強さが高温加熱、湿式処理、半田付け、薬品処理等の後でも充分なこと、
 - ③基材との積層、エッチング後に生じる所謂積層汚点のないこと
- 等が挙げられる。

【0004】 粗化処理は銅箔と基材との接着性を決定するものとして、大きな役割を担っている。粗化処理としては、当初銅を電着する銅粗化処理が採用されていたが、その後様々の技術が提唱され、特に耐熱剥離強度、耐塩酸性及び耐酸化性の改善を目的として銅-ニッケル粗化処理が一つの代表的処理方法として定着するようになった。本件出願人は、特開昭52-145769号において銅-ニッケル粗化処理を提唱し、成果を納めてきた。銅-ニッケル処理表面は黒色を呈し、特にフレキシブル基板用圧延処理箔では、この銅-ニッケル処理の黒色が商品としてのシンボルとして認められるに至っている。

【0005】 しかしながら、銅-ニッケル粗化処理は、耐熱剥離強度及び耐酸化性並びに耐塩酸性に優れる反面、近時ファインパターン用処理として重要となってきたアルカリエッチング液でのエッチングが困難であり、150 μm ピッチ回路巾以下のファインパターン形成時に処理層がエッチング残となってしまう。

【0006】 そこで、ファインパターン用処理として、本件出願人は、先にCu-Cr処理（特公昭63-2158号及び特願平1-112227号）及びCu-Cr-Ni処理（特願平1-112226号）を開発した。これら粗化処理は、エッチング性、アルカリエッチング性及び耐塩酸性については良好であったが、アクリル系接着剤を用いたときの耐熱剥離強度が低下することが改めて判明し、また耐酸化性も所期程充分ではなくそして色調も黒色までには至らず、茶～こげ茶色であった。

【0007】 最近の印刷回路のファインパターン化及び多様化への趨勢にともない、

- ①Cu-Ni処理の場合に匹敵する耐熱剥離強度（特にアクリル系接着剤を用いたとき）及び耐塩酸性を有すること、

②アルカリエッチング液で $150\mu\text{m}$ ピッチ回路巾以下の印刷回路をエッチングできること、

③Cu-Ni処理の場合と同様に、耐酸化性（ $180^{\circ}\text{C} \times 30$ 分のオープン中での耐酸化性）を向上すること、

④Cu-Ni処理の場合と同様の黒化処理であることが更に要求されるようになった。即ち、回路が細くなると、塩酸エッチング液により回路が剥離し易くなる傾向が強まり、その防止が必要である。回路が細くなると、半田付け等の処理時の高温により回路がやはり剥離し易くなり、その防止もまた必要である。ファインパターン化が進む現在、例えばCuCl₂エッチング液で $150\mu\text{m}$ ピッチ回路巾以下の印刷回路をエッチングできることはもはや必須の要件であり、レジスト等の多様化にともないアルカリエッチングも必要要件となりつつある。黒色表面も、位置合わせ精度及び熱吸収を高めることで銅箔の製作及びチップマウントの観点から重要となっている。

【0008】こうした要望に答えて、本件出願人は、銅箔の表面に銅-コバルト-ニッケルから成るめっきによる粗化処理後、コバルトめっき層或いはコバルト及びニッケルから成るめっき層を形成することにより、印刷回路銅箔として上述した多くの一般的特性を具備することはもちろんのこと、特にCu-Ni処理と匹敵する上述した諸特性を具備し、しかもアクリル系接着剤を用いたときの耐熱剥離強度を低下せず、耐酸化性に優れそして表面色調も黒色である銅箔処理方法を開発することに成功した（特公平6-54831号）。好ましくは、前記コバルトめっき層或いはコバルト及びニッケルから成るめっき層を形成した後に、クロム酸化物の単独皮膜処理或いはクロム酸化物と亜鉛及び（又は）亜鉛酸化物との混合皮膜処理を代表とする防錆処理が施される。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】その後、電子機器の発展が進む中で、半導体デバイスの小型化、高集積化が更に進み、これらの印刷回路の製造工程で行われる処理が一段と高温となりまた製品となった後の機器使用中の熱発生により、銅箔と樹脂基材との間での接合力の低下があらためて問題となるようになった。本発明の課題は、特公平6-54831号において確立された銅箔の表面に銅-コバルト-ニッケルから成るめっきによる粗化処理後、コバルトめっき層或いはコバルト及びニッケルから成るめっき層を形成する印刷回路用銅箔の処理方法において耐熱剥離性を更に一層改善することである。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明者らの研究の結果、銅箔の表面に銅-コバルト-ニッケルから成るめっきによる粗化処理後、コバルトめっき層を形成し、更にその上に亜鉛層を形成することにより、これまでの利点を生かしたまま耐熱剥離性を一層改善しうることが明らかとなった。この知見に基づいて、本発明は、印刷回路

用銅箔の処理方法において、銅箔の表面に銅-コバルト-ニッケルから成るめっきによる粗化処理後、コバルトめっき層を形成し、更に亜鉛層を形成することを特徴とする印刷回路用銅箔の処理方法を提供するものである。好ましくは、前記コバルトめっき層或いはコバルト及びニッケルから成るめっき層を形成した後に、クロム酸化物の単独皮膜処理或いはクロム酸化物と亜鉛及び（又は）亜鉛酸化物との混合皮膜処理を代表とする防錆処理が施される。

【0011】特定的には、印刷回路用銅箔の処理方法において、銅箔の表面に付着量が $15 \sim 40\text{mg}/\text{dm}^2$ 銅- $100 \sim 3000\mu\text{g}/\text{dm}^2$ 、好ましくは $2000 \sim 3000\mu\text{g}/\text{dm}^2$ コバルト- $100 \sim 1000\mu\text{g}/\text{dm}^2$ 、好ましくは $200 \sim 400\mu\text{g}/\text{dm}^2$ ニッケルであるような銅-コバルト-ニッケルから成る合金めっきによる粗化処理後、 $200 \sim 3000\mu\text{g}/\text{dm}^2$ 、好ましくは $500 \sim 3000\mu\text{g}/\text{dm}^2$ の付着量のコバルトめっき層を形成し、更に $10 \sim 80\mu\text{g}/\text{dm}^2$ 、好ましくは $20 \sim 60\mu\text{g}/\text{dm}^2$ 、一層好ましくは $30 \sim 50\mu\text{g}/\text{dm}^2$ 付着量の亜鉛層を形成する。

【0012】

【作用】本発明において使用する銅箔は、電解銅箔或いは圧延銅箔いずれでも良い。通常、銅箔の、樹脂基材と接着する面即ち粗化面には積層後の銅箔の引き剥し強さを向上させることを目的として、脱脂後の銅箔の表面にふしこぶ状の電着を行なう粗化処理が施される。電解銅箔は製造時点で凹凸を有しているが、粗化処理により電解銅箔の凸部を増強して凹凸を一層大きくする。本発明においては、この粗化処理は銅-コバルト-ニッケル合金めっきにより行なわれる。粗化前の前処理として通常の銅めっき等がそして粗化後の仕上げ処理として電着物の脱落を防止するために通常の銅めっき等が行なわれることもある。圧延銅箔と電解銅箔とでは処理の内容を幾分異にすることもある。本発明においては、こうした前処理及び仕上げ処理をも含め、銅箔粗化と関連する公知の処理を必要に応じて含め、総称して粗化処理と云うものとする。

【0013】本発明に従えば、粗化処理としての銅-コバルト-ニッケル合金めっきは、電解めっきにより、付着量が $15 \sim 40\text{mg}/\text{dm}^2$ 銅- $100 \sim 3000\mu\text{g}/\text{dm}^2$ コバルト- $100 \sim 1000\mu\text{g}/\text{dm}^2$ ニッケルであるような3元系合金層を形成するように実施される。Co付着量が $100\mu\text{g}/\text{dm}^2$ 未満では、耐熱性が悪化し、エッチング性が悪くなる。Co付着量が $3000\mu\text{g}/\text{dm}^2$ を超えると、磁性の影響を考慮せねばならない場合には好ましくなく、エッチングシミが生じ、また、耐酸性及び耐薬品性の悪化が考慮される。Ni付着量が $100\mu\text{g}/\text{dm}^2$ 未満であると、耐熱性が悪くなる。他方、Ni付着量が $1000\mu\text{g}/\text{dm}^2$

m^2 を超えると、エッチング残が多くなる。ただし、Ni 付着量が $500 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ を超えると、エッチング性が低下する傾向がある。すなわち、エッチング残ができたり、エッチングできないというレベルではないが、ファインパターン化が難しくなる。好ましいCo付着量は $2000 \sim 3000 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ でありそして好ましいニッケル付着量は $200 \sim 400 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ である。ここで、エッチングシミとは、塩化銅でエッチングした場合、Coが溶解せずに残ってしまうことを意味しそしてエッチング残とは塩化アンモニウムでアルカリエッチングした場合、Niが溶解せずに残ってしまうことを意味するものである。

【0014】こうした3元系合金めっきを形成するための一般的浴及びめっき条件は次の通りである：

(Cu-Co-Ni 3元合金めっき条件)

Cu : $10 \sim 20 \text{g}/\text{リットル}$

Co : $1 \sim 10 \text{g}/\text{リットル}$

Ni : $1 \sim 10 \text{g}/\text{リットル}$

pH : $1 \sim 4$

温度 : $40 \sim 50^\circ\text{C}$

電流密度 D_k : $20 \sim 30 \text{A}/\text{dm}^2$

時間 : $1 \sim 5$ 秒

【0015】本発明は、粗化処理後、粗化面上に $200 \sim 3000 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ の付着量のコバルトめっき層を形成する。このコバルトめっきは、銅箔と基板の接着強度を実質的に低下させない程度に行なう必要がある。コバルト付着量が $200 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ 未満では、耐熱剥離強度が低下し、耐酸化性及び耐薬品性が悪化する。また、もう一つの理由として、Co量が少ないと処理表面が赤っぽくなってしまっているので好ましくない。コバルト付着量が $3000 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ を超えると、磁性の影響を考慮せねばならない場合には好ましくなく、エッチングシミが生じ、また、耐酸性及び耐薬品性の悪化が考慮される。好ましいコバルト付着量は $500 \sim 3000 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ である。

【0016】コバルトめっきの条件は次の通りである：

(コバルトめっき)

Co : $1 \sim 30 \text{g}/\text{リットル}$

pH : $1.5 \sim 3.5$

温度 : $30 \sim 80^\circ\text{C}$

D_k : $1.0 \sim 20.0 \text{A}/\text{dm}^2$

時間 : $0.5 \sim 4$ 秒

【0017】本発明に従えば、コバルトめっき上に更に $10 \sim 80 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ 付着量の亜鉛めっきが形成される。亜鉛付着量が $10 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ 未満では耐熱劣化率改善効果がない(耐熱劣化率が40%以上となる。)他方、亜鉛付着量が $80 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ を超えると耐塩酸劣化率が極端に悪くなる(50%以上となる)。好ましくは、亜鉛付着量は $20 \sim 60 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ とされ、特に好ましくは $30 \sim 50 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ とされる。亜鉛め

き条件は次の通りである：

Zn : $100 \sim 300 \text{g}/\text{リットル}$

pH : $3 \sim 4$

温度 : $50 \sim 60^\circ\text{C}$

D_k : $0.1 \sim 0.5 \text{A}/\text{dm}^2$

時間 : $1 \sim 3$ 秒

【0018】この後、必要に応じ防錆処理が実施される。本発明において好ましい防錆処理は、クロム酸化物単独の皮膜処理或いはクロム酸化物と亜鉛/亜鉛酸化物との混合物皮膜処理である。クロム酸化物と亜鉛/亜鉛酸化物との混合物皮膜処理とは、亜鉛塩または酸化亜鉛とクロム酸塩とを含むめっき浴を用いて電気めっきにより亜鉛または酸化亜鉛とクロム酸化物とより成る亜鉛-クロム基混合物の防錆層を被覆する処理である。めっき浴としては、代表的には、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 等の重クロム酸塩や CrO_3 等の少なくとも一種と、水溶性亜鉛塩、例えば ZnO 、 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 等少なくとも一種と、水酸化アルカリとの混合水溶液が用いられる。代表的なめっき浴組成と電解条件例は次の通りである：

(クロム防錆処理)

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 或いは CrO_3) : $2 \sim 10 \text{g}/\text{リットル}$

NaOH 或いは KOH : $10 \sim 50 \text{g}/\text{リットル}$

ZnO 或いは $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: $0.05 \sim 10 \text{g}/\text{リットル}$

pH : $7 \sim 13$

浴温 : $20 \sim 80^\circ\text{C}$

電流密度 : $0.05 \sim 5 \text{A}/\text{dm}^2$

時間 : $5 \sim 30$ 秒

アノード : Pt-Ti 板、ステンレス鋼板等

クロム酸化物はクロム量として $15 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ 以上そして亜鉛は $30 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ 以上の被覆量が要求される。

【0019】こうして得られた銅箔は、優れた耐熱性剥離強度、耐酸化性及び耐塩酸性を有し、しかも CuCl_2 エッチング液で $150 \mu\text{m}$ ピッチ回路巾以下の印刷回路をエッチングでき、しかもアルカリエッチングも可能とする。アルカリエッチング液としては、例えば、 NH_4OH : 6モル/l ; NH_4Cl : 5モル/l ; CuCl_2 : 2モル/l (温度 50°C) 等の液が知られている。

【0020】更に重要なことは、得られた銅箔は、Cu-Ni 処理の場合と同じく黒色を有していることである。こうした黒色は、位置合わせ精度及び熱吸収率の高いことの点から重要である。詳しくは、リジッド基板及びフレキシブル基板を含め印刷回路基板は、ICや抵抗、コンデンサ等の部品を自動工程で搭載していくが、その際センサーにより回路を読み取りながらチップマウントを行なっている。このとき、カプトンなどのフィルムを通して銅箔処理面での位置合わせを行なうことがある。また、スルーホール形成時の位置決めも同様である。このとき処理面が黒に近い程、光の吸収が良いた

め、位置決めの精度が高くなる。更には、基板を作製する際、銅箔とフィルムとを熱を加えながらキュウリングして接着させることが多い。このとき、遠赤外線、赤外線等の長波長波を用いることにより加熱する場合、処理面の色調が黒い方が加熱効率が良くなる。

【0021】最後に、必要に応じ、銅箔と樹脂基板との接着力の改善を主目的として、防錆層上の少なくとも粗化面にシランカップリング剤を塗布するシラン処理が施される。塗布方法は、シランカップリング剤溶液のスプレーによる吹付け、コーターでの塗布、浸漬、流しかけ等いずれでもよい。例えば、特公昭60-15654号は、銅箔の粗面側にクロメート処理を施した後シランカップリング剤処理を行なうことによって銅箔と樹脂基板との接着力を改善することを記載している。詳細はこれを参照されたい。この後、必要なら、銅箔の延性を改善する目的で焼鈍処理を施すこともある。

【0022】

【実施例】以下に、実施例及び比較例を呈示する。圧延銅箔に前述した条件範囲で銅-コバルト-ニッケルめっき粗化処理を施して、銅を $17\text{mg}/\text{dm}^2$ 、コバルトを $2200\mu\text{g}/\text{dm}^2$ そしてニッケルを $300\mu\text{g}/\text{dm}^2$ 付着した後に、水洗し、その上にコバルトめっきを形成した。コバルト付着量は $700\mu\text{g}/\text{dm}^2$ とした。従って、コバルトの合計付着量は $2900\mu\text{g}/\text{dm}^2$ であった。サンプルNo. 2については、コバルト付着量を増加させた例(サンプルNo. 2A及び2B)を追加した。水洗後、 $10\sim 90\mu\text{g}/\text{dm}^2$ の範囲で変化させて亜鉛を付着し、最後に防錆処理を行ないそして乾燥した。亜鉛を付着しない比較例サンプルをサンプルNo. 10として用意した。

【0023】サンプルをガラスクロス基材エポキシ樹脂板に積層接着し、常態(室温)剥離強度(kg/cm)を測定し耐熱劣化は $180^\circ\text{C}\times 48$ 時間加熱後の剥離強度の劣化率(%)として示し、そして耐塩酸劣化は18%塩酸に1時間浸漬した後の剥離強度を 0.2mm 幅 $\times 10$ 本回路で測定した場合の劣化率(%)として示した。アルカリエッチングは下記の液を使用してエッチング状態の目視による観察をした。

(アルカリエッチング液)

NH_4OH : $6\text{mol}/\text{l}$

NH_4Cl : $5\text{mol}/\text{l}$

$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: $2\text{mol}/\text{l}$

温度: 50°C

【0024】使用した浴組成及びめっき条件は次の通りであった:

[浴組成及びめっき条件]

(A) 粗化処理(Cu-Co-Ni)

Cu: $15\text{g}/\text{l}$

Co: $8.5\text{g}/\text{l}$

Ni: $8.6\text{g}/\text{l}$

pH: 2.5

温度: 38°C

Dk: $20\text{A}/\text{dm}^2$

時間: 2秒

銅付着量: $17\text{mg}/\text{dm}^2$

コバルト付着量: $2200\mu\text{g}/\text{dm}^2$

ニッケル付着量: $300\mu\text{g}/\text{dm}^2$

(B) 防錆処理(Co)

Co: $10\text{g}/\text{l}$

pH: 2.5

温度: 50°C

Dk: $5.6\sim 14.4\text{A}/\text{dm}^2$

時間: 0.5秒

コバルト付着量: $700\sim 2600\mu\text{g}/\text{dm}^2$

(C) 耐熱剥離性改善処理(Zn)

Zn: $200\text{g}/\text{l}$

pH: 3.7

温度: 56°C

Dk: $0.1\sim 0.5\text{A}/\text{dm}^2$

時間: 1秒

(D) 防錆処理(クロメート)

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ あるいは CrO_3): $5\text{g}/\text{l}$

NaOH あるいは KOH : $30\text{g}/\text{l}$

ZnO あるいは $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: $5\text{g}/\text{l}$

pH: 10

温度: 40°C

Dk: $2\text{A}/\text{dm}^2$

時間: 10秒

アノード: Pt-Ti板

【0025】

【表1】

サンプル No.	付着量 ($\mu\text{g}/\text{dm}^2$)			常態 kg/cm	耐熱劣化 (%)	耐塩酸劣化 (%)
	Zn	Ni	Co			
1	10	300	2900	1.17	39.5	0
2	20	300	2900	1.17	35.9	3.6
2A	20	300	3700	1.18	21.7	5.4
2B	20	300	4800	1.18	20.0	3.3
3	30	300	2900	1.16	29.7	5.1
4	40	300	2900	1.15	25.9	11.7
5	50	300	2900	1.16	23.9	16.8
6	60	300	2900	1.16	21.5	25.0
7	70	300	2900	1.15	19.5	35.5
8	80	300	2900	1.16	19.0	47.5
9	90	300	2900	1.15	18.5	61.5
比較例						
10	0	300	2900	1.18	44.0	0

【0026】亜鉛付着量が $10\mu\text{g}/\text{dm}^2$ 未満では耐熱劣化率が40%以上となり、好ましくない。他方、亜鉛付着量が $80\mu\text{g}/\text{dm}^2$ を超えると耐塩酸劣化率50%以上となり、好ましくない。両者を勘案して、好ましくは、亜鉛付着量は $20\sim 60\mu\text{g}/\text{dm}^2$ とされ、特に好ましくは $30\sim 50\mu\text{g}/\text{dm}^2$ である。アルカリエッチング性はすべて良好であった。

【0027】

【発明の効果】本発明は、銅箔の表面に銅-コバルト-ニッケルから成るめっきによる粗化処理後、コバルトめっき層を形成する印刷回路用銅箔の処理方法において、その有益な利点を生かしたまま、耐熱剥離性を更に一層改善することに成功し、近時の半導体デバイスの急激な発展に伴う処理の高温化並びに印刷回路用的高密度及び高多層化に対応し得る銅箔の処理方法を提供する。